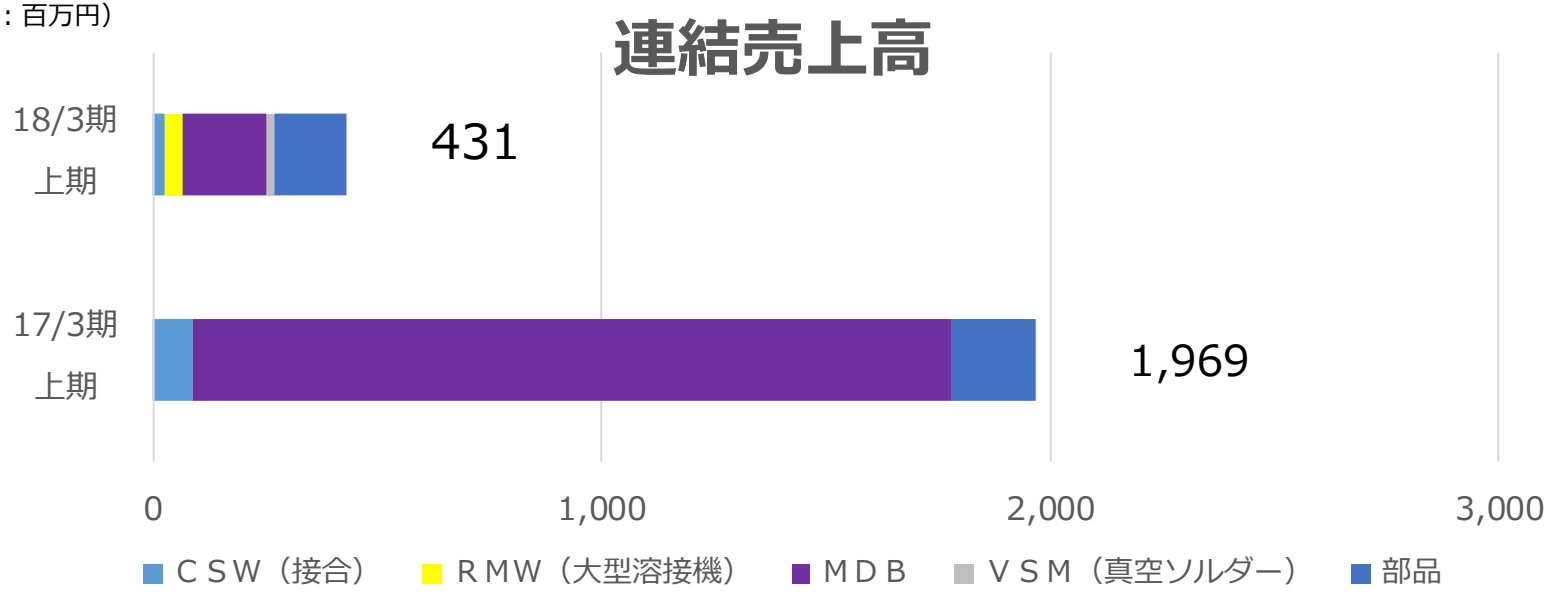
メカトロニクス事業　連結業績詳細

（単位：百万円）



18/3期　上期売上概況

- MDBは大型案件及び中国販売進まず
- CSWは市場の縮小及び価格競争により販売進まず
- 改良版VSMは当初計画に対し市場投入の遅れが影響

18/3期　下期重点施策

- MDB受注活動、DB[*1](車載)市場開拓
- RMWはリングマッシュ工法浸透により自動車市場拡大
- VSMはPD[*2]/LED市場開拓、海外市場展開

*1 新製品　*2 パワーデバイス

新製品情報

製品名：車載向けディスプレイ貼り合せ装置（ＤＢ）

特長

- 低コストの精密常圧貼り合せ
- 6.5～17.7″のパネルサイズに対応
- 電圧印加法によるバブルフリーボンディング
- シール剤、ダム剤塗布に対応

用途

- 車載及び産業用ディスプレイの貼り合せ

型式：ＬＣ１Ｃｏ

ＤＢ（Display Bonder）の用途

モバイルフォン(MDB)から車載用途(DB）への展開

車載用途から産業用途へ市場拡大

etc.